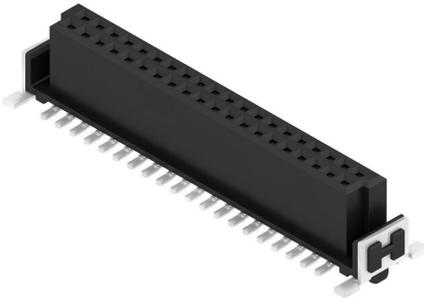


제품 이미지



OMNIMATE® 보드 투 보드(Board-to-Board) 커넥터
컴팩트한 장치의 유연한 엔지니어링
미래 대비형 컨택트 시스템의 사용과 제조 공정의 최적화는
효율적인 산업용 장치의 개발, 특히 Industry 4.0 분야에서
그 중요성이 날로 커지고 있습니다. OMNIMATE® 보드
투 보드 커넥터는 피치 1.27mm로, 각기 다른 설계에 대해
최대한의 유연성을 제공합니다.

- 유연한 장치 설계 - 산업 용도로 적합한 밀도와 고도의 유연성을 가진 결선 조합의 만남 (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Extender-card, Cable-to-Board)
- 자동화 준비 완료 - 고정밀 핀 동일평면성 및 SMT 고정 기능을 갖춘 자동 조립 용도로 개발
- 신뢰도 높은 접점 - 산업용 적합 금도금(PdNi-Au)을 적용해 체결 주기 최대 500회
- 공정 준비 완료 - 리플로우 솔더링을 위한 고성능 LCP 소재
- 확장성 - 높이가 각기 다르고 고접점 중첩이 있어 12~80개 풀까지 다양한 솔루션을 보장합니다.
- 활용도 높은 소형화 - 경사 또는 오프셋 등, 까다로운 체결 조건에서도 간편하고 안전한 결선 가능.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, SMD 용접 결선, 피치(mm)(P): 1.27 mm, 극 수: 40, 180°, Tape |
| 주문 번호 | 2747300000 |
| 유형 | FFH6 S1/40V F1 B RL |
| GTIN (EAN) | 4064675000891 |
| 수량 | 280 items |
| 제품 데이터 | IEC: / 2.8 A UL: 150 V |
| 패키징 | Tape |

FFH6 S1/40V F1 B RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | 준수 |
| UL File Number Search | UL 웹사이트 |
| 인증 번호(cURus) | E92202 |

치수 및 중량

| | | | |
|-----|----------|---------|-------------|
| 깊이 | 7.8 mm | 깊이 (인치) | 0.3071 inch |
| 높이 | 7.1 mm | 높이 (인치) | 0.2795 inch |
| 너비 | 30.48 mm | 폭 (인치) | 1.2 inch |
| 순중량 | 6.43 g | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

시스템 사양

| | | | |
|---------------|--------------|-------------|-----------------------|
| 전송 속도 | 3.125 Gbit/s | 제품군 | OMNIMATE 신호 - 보드 투 보드 |
| 결선 유형 | 보드 결선 | PCB에 장착 | SMD 용접 결선 |
| 피치(mm)(P) | 1.27 mm | 피치(인치)(P) | 0.050 " |
| 외향 앵글 | 180° | 극 수 | 40 |
| 플랫 용접 핀 수 | 1 | 공면: | 0.1 mm |
| 행 수 | 1 | 핀 시리즈 수량 | 2 |
| 보호 등급 | IP20 | 볼륨 저항 | <25 mΩ |
| 플러그 주기 | 500 | 플러깅 힘/폴, 최대 | 0.6 N |
| 당기는 힘 / 폴, 최대 | 0.6 N | | |

자재 데이터

| | | | |
|----------------|--|----------------------|---------|
| 절연재 | LCP | 컬러 코드 | 검정 |
| 컬러 차트(유사) | RAL 9011 | 절연재 그룹 | IIIa |
| 절연 저항 | ≥ 10 ¹⁰ Ω | Moisture Level (MSL) | 1 |
| UL 94 가연성 등급 | V-0 | 접점 기본 재질 | 구리 합금 |
| 접점 재질 | 구리 합금 | 접점 표면 | 금 도금 니켈 |
| 플러그 접점의 레이어 구조 | ≥ 2 μm Ni / ≥ 0.4 μm PdNi / ≥ 0.05 μm Au | 보관 온도, 최소 | -40 °C |
| 보관 온도, 최대 | 70 °C | 작동 온도, 최소 | -55 °C |
| 작동 온도, 최대 | 125 °C | | |

IEC 정격데이터

| | | | |
|---------------------|--------|---------|--------|
| 정격 전류, 극 수(Tu=20°C) | 2.8 A | 연면거리, 분 | 0.4 mm |
| 최소간격, 분 | 0.4 mm | | |

UL 1977에 따른 정격 데이터

| | | | |
|--------|------------------------|--------------------|-------|
| 승인값 참조 | 사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조 | 정격 전압(UL 1977)(구형) | 150 V |
|--------|------------------------|--------------------|-------|

FFH6 S1/40V F1 B RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

패키징

| | | | |
|-------|-----------|--------|-----------|
| 패키징 | Tape | VPE 길이 | 350.00 mm |
| VPE 폭 | 340.00 mm | VPE 높이 | 135.00 mm |

중요 참고 사항

| | |
|--------|---|
| IPC 준수 | 적합성: 본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다. |
|--------|---|

참고 사항

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002637 | ETIM 9.0 | EC002637 |
| ETIM 10.0 | EC002637 | ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 | | |

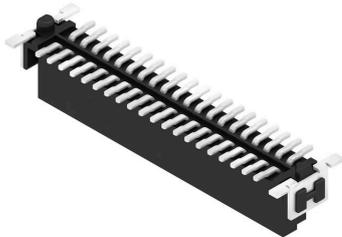
FFH6 S1/40V F1 B RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

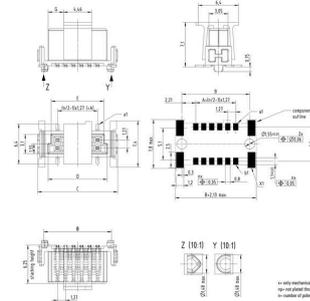
도면

제품 이미지

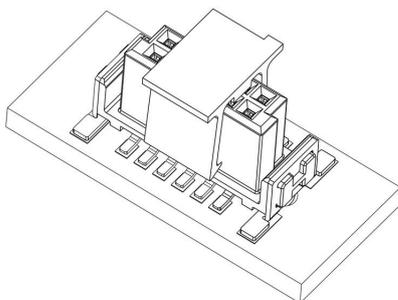


Dimensional drawing

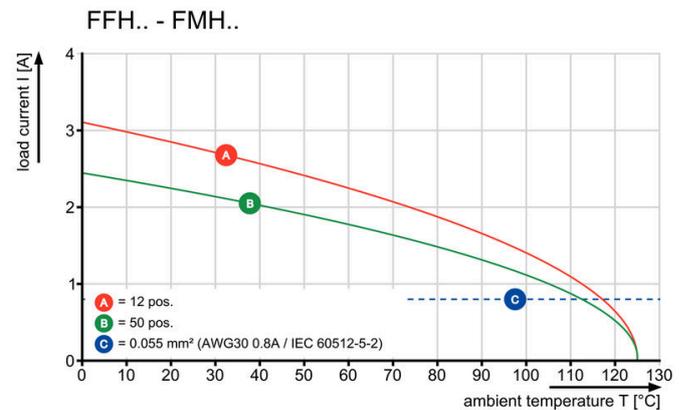
| Type | Order no. | No. of pairs | A | B | C | D | E | G |
|---------------------|------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| FFH6 S1/20V F1 B RL | 2747200000 | 12 | 6.36 | 10.17 | 12.7 | 9.37 | 8.37 | 2.46 |
| FFH6 S1/16V F1 B RL | 2747200000 | 16 | 6.89 | 13.31 | 15.24 | 11.91 | 10.91 | 3.73 |
| FFH6 S1/20V F1 B RL | 2747200000 | 20 | 11.43 | 15.86 | 17.78 | 14.45 | 13.45 | 5 |
| FFH6 S1/20V F1 B RL | 2747200000 | 25 | 15.45 | 19.69 | 21.59 | 18.26 | 17.26 | 7.64 |
| FFH6 S1/20V F1 B RL | 2747200000 | 32 | 18.5 | 23.67 | 25.4 | 22.07 | 21.07 | 8.91 |
| FFH6 S1/16V F1 B RL | 2747200000 | 40 | 25.13 | 28.59 | 30.48 | 27.16 | 26.16 | 11.26 |
| FFH6 S1/16V F1 B RL | 2747200000 | 50 | 30.48 | 34.29 | 36.19 | 32.8 | 31.8 | 15.19 |
| FFH6 S1/16V F1 B RL | 2747200000 | 68 | 41.91 | 46.31 | 48.26 | 44.93 | 43.93 | 20.24 |
| FFH6 S1/16V F1 B RL | 2747200000 | 80 | 46.31 | 53.95 | 55.89 | 52.56 | 51.56 | 24.66 |

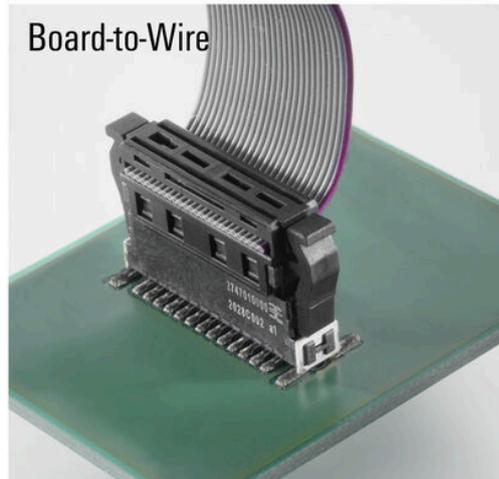
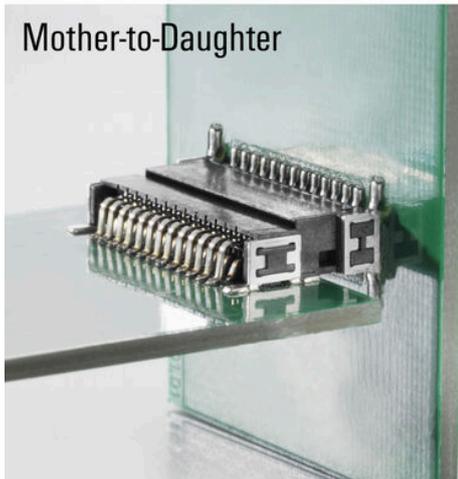
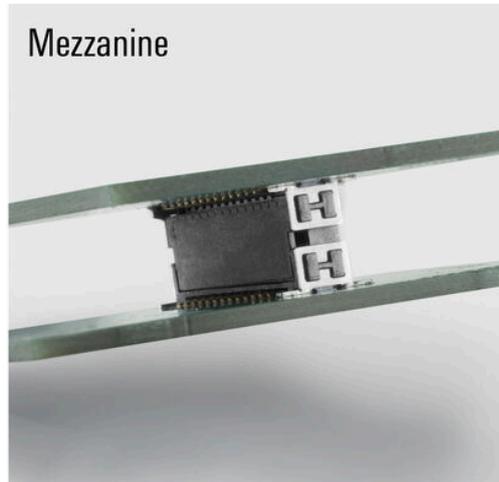
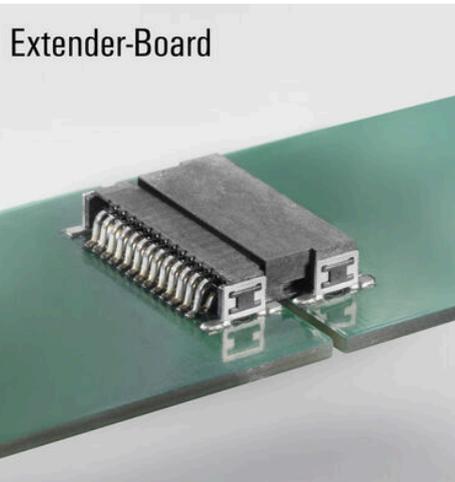


상세 도면



감소 곡선





FFH6 S1/40V F1 B RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

대응물

FMH - 수형 헤더, 보드 결선



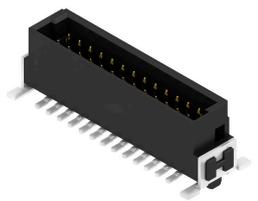
OMNIMATE® 보드 투 보드(Board-to-Board) 커넥터
 컴팩트한 장치의 유연한 엔지니어링
 미래 대비형 컨택트 시스템의 사용과 제조 공정의 최적화는
 효율적인 산업용 장치의 개발, 특히 Industry 4.0 분야에서
 그 중요성이 날로 커지고 있습니다. OMNIMATE® 보드
 투 보드 커넥터는 피치 1.27mm로, 각기 다른 설계에 대해
 최대한의 유연성을 제공합니다.

- 유연한 장치 설계 - 산업 용도로 적합한 밀도와 고도의 유연성을 가진 결선 조합의 만남 (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Extender-card, Cable-to-Board)
- 자동화 준비 완료 - 고정밀 핀 동일평면성 및 SMT 고정 기능을 갖춘 자동 조립 용도로 개발
- 신뢰도 높은 접점 - 산업용 적합 금도금(PdNi-Au)을 적용해 체결 주기 최대 500회
- 공정 준비 완료 - 리플로우 솔더링을 위한 고성능 LCP 소재
- 확장성 - 높이가 각기 다르고 고점점 중첩이 있어 12~80개 풀까지 다양한 솔루션을 보장합니다.
- 활용도 높은 소형화 - 경사 또는 오프셋 등, 까다로운 체결 조건에서도 간편하고 안전한 결선 가능.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형 | FMH S1/40H F1 B RL | 버전 | |
| 주문 번호 | 2747210000 | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, SMD 용접 결선, 피치(mm)(P): 1.27 | |
| GTIN (EAN) | 4064675001034 | mm, 극 수: 40, 90°, Tape | |
| 수량 | 560 ST | | |

FMH1 - 수형 헤더, 보드 결선(스택 높이 1.75mm)



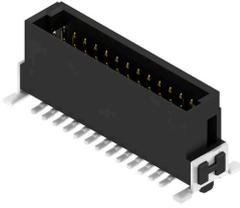
OMNIMATE® 보드 투 보드(Board-to-Board) 커넥터
 컴팩트한 장치의 유연한 엔지니어링
 미래 대비형 컨택트 시스템의 사용과 제조 공정의 최적화는
 효율적인 산업용 장치의 개발, 특히 Industry 4.0 분야에서
 그 중요성이 날로 커지고 있습니다. OMNIMATE® 보드
 투 보드 커넥터는 피치 1.27mm로, 각기 다른 설계에 대해
 최대한의 유연성을 제공합니다.

- 유연한 장치 설계 - 산업 용도로 적합한 밀도와 고도의 유연성을 가진 결선 조합의 만남 (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Extender-card, Cable-to-Board)
- 자동화 준비 완료 - 고정밀 핀 동일평면성 및 SMT 고정 기능을 갖춘 자동 조립 용도로 개발
- 신뢰도 높은 접점 - 산업용 적합 금도금(PdNi-Au)을 적용해 체결 주기 최대 500회
- 공정 준비 완료 - 리플로우 솔더링을 위한 고성능 LCP 소재
- 확장성 - 높이가 각기 다르고 고점점 중첩이 있어 12~80개 풀까지 다양한 솔루션을 보장합니다.
- 활용도 높은 소형화 - 경사 또는 오프셋 등, 까다로운 체결 조건에서도 간편하고 안전한 결선 가능.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형 | FMH1 S1/40V F1 B RL | 버전 | |
| 주문 번호 | 2747030000 | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, SMD 용접 결선, 피치(mm)(P): 1.27 | |
| GTIN (EAN) | 4064675001485 | mm, 극 수: 40, 180°, Tape | |
| 수량 | 280 ST | | |

FMH3 - 수형 헤더, 보드 결선(스택 높이 3.25mm)



OMNIMATE® 보드 투 보드(Board-to-Board) 커넥터
컴팩트한 장치의 유연한 엔지니어링
미래 대비형 컨택트 시스템의 사용과 제조 공정의 최적화는
효율적인 산업용 장치의 개발, 특히 Industry 4.0 분야에서
그 중요성이 날로 커지고 있습니다. OMNIMATE® 보드
투 보드 커넥터는 피치 1.27mm로, 각기 다른 설계에 대해
최대한의 유연성을 제공합니다.

- 유연한 장치 설계 - 산업 용도로 적합한 밀도와 고도의 유연성을 가진 결선 조합의 만남 (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Extender-card, Cable-to-Board)
- 자동화 준비 완료 - 고정밀 핀 동일평면성 및 SMT 고정 기능을 갖춘 자동 조립 용도로 개발
- 신뢰도 높은 접점 - 산업용 적합 금도금(PdNi-Au)을 적용해 체결 주기 최대 500회
- 공정 준비 완료 - 리플로우 솔더링을 위한 고성능 LCP 소재
- 확장성 - 높이가 각기 다르고 고접점 중첩이 있어 12~80개 폴까지 다양한 솔루션을 보장합니다.
- 활용도 높은 소형화 - 경사 또는 오프셋 등, 까다로운 체결 조건에서도 간편하고 안전한 결선 가능.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형 | FMH3 S1/40V F1 B RL | 버전 | |
| 주문 번호 | 2747120000 | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, SMD 용접 결선, 피치(mm)(P): 1.27 | |
| GTIN (EAN) | 4064675001164 | mm, 극 수: 40, 180°, Tape | |
| 수량 | 280 ST | | |